BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-236872

(43)Date of publication of application: 13.09.1996

(51)Int.CI.

H01S 3/18 H01L 33/00

(21)Application number: 07-062108

•

(22)Date of filing:

24.02.1995

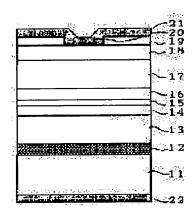
(71)Applicant: VICTOR CO OF JAPAN LTD

(72)Inventor: MORITA KATSUHIKO

(54) SEMICONDUCTOR LASER

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a high-reliability semiconductor laser by suppressing the generation of heat by reducing potential barrier. CONSTITUTION: A p-ZnCdSe/ZnSe superlattice layer 12, a p-ZnMgSSe clad layer 13, a p-ZnSe light guide layer 14, a u-ZnCdSe active layer 15, an n-ZnSe light guide layer 16, an n-ZnMgSSe clad layer 17, and an n-ZnSe contact layer 18 are sequentially grown on p-GaAs substrate 11. Next, polyimide 19 is applied to the n-ZnSe contact layer 18, a stripe portion 20 is opened and an n-type electrode (AuGeNi/Au) 21 is formed, and p-type electrode (AuZn/Au) 22 is formed on the surface of the p-GaAs substrate 11. The p-ZnCdSe/ZnSe superlattice layer 12 is laminated with a plurality of pairs of p-ZnCdSe and p-ZnSe, each pair being 20 Angstrom as one unit.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-236872

(43)公開日 平成8年(1996)9月13日

(51) Int.Cl.⁶

庁内整理番号 識別記号

FΙ

技術表示箇所

H01S 3/18 H01L 33/00 H01S 3/18

H01L 33/00

D

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 3 頁)

(21) 出願番号

(22)出願日

特願平7-62108

平成7年(1995)2月24日

(71)出願人 000004329

日本ピクター株式会社

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番

(72)発明者 森田 克彦

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番

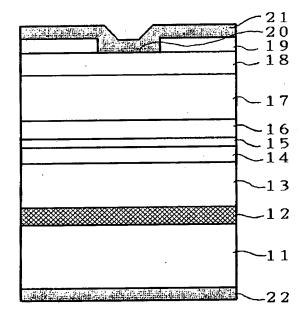
地 日本ピクター株式会社内

(54) 【発明の名称】 半導体レーザ

(57)【要約】

【目的】 電位障壁を低減することによって熱の発生を 抑え、髙信頼性の半導体レーザを提供する。

【構成】 p-GaAs基板11上に、p-ZnCdS e/ZnSe超格子層12、p-ZnMgSSeクラッ ド層13、p-ZnSe光ガイド層14、u-ZnCd Se活性層15、n-ZnSe光ガイド層16、n-Z nMgSSeクラッド層17、n-ZnSeコンタクト 層18を順次成長させる。次に、ポリイミド19をn-ZnSeコンタクト層18の上に塗布し、ストライプ部 20を開けn型電極 (AuGeNi/Au) 21を形成 し、p-GaAs基板11面にp型電極(AuZn/A u) 22を形成する。p-ZnCdSe/ZnSe超格 子層 1 2 は、20オングストロームを1 単位とする p - Z nCdSeとp-ZnSeとのペアが複数積層されてい る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも、p型GaAs基板上にZnS e系半導体のp型クラッド層、活性層及びn型クラッド 層を有する半導体レーザにおいて、

前記p型GaAs基板と前記p型クラッド層との間に、 p型ZnCdSe層とp型ZnSe層とを交互に複数積 層した超格子層を有することを特徴とする半導体レー

【請求項2】前記超格子層上にp型ZnMgSSeクラ ッド層、ZnCdSe系半導体の活性層及びn型ZnM 10 gSSeクラッド層を有することを特徴とする請求項1 に記載の半導体レーザ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、II-VI 族化合物半導体 を用いた端面発光型の半導体レーザ(LD)に関する。 [0002]

【従来の技術】従来から、例えば可視光短波長半導体レ ーザはn型基板を用いて作られているが、ZnCdSS e系半導体結晶ではp型結晶のキャリア濃度が低いた め、p型電極とオーミック接触にならないという理由か ら、LD構造はp型基板を用いn型半導体を上方にした 構造にしている。

【0003】図2は、この様な従来の半導体レーザの一 例を示す図である。同図において、p-GaAs基板3 1上にp-ZnSeバッファ層32、p-ZnSSeク ラッド層33、p-ZnSe光ガイド層34、u(アン ドープ) – ZnCdSe活性層35、n – ZnSe光ガ イド層36、n-ZnSSeクラッド層37、n+-ZnSeコンタクト層39が順次積層されている。これら 30 はMBE(分子線エピタキシャル成長)法により作製さ れている。40はイオン注入された高抵抗領域である。 また、n型電極41としてAu/Ti電極が、n-Zn Seコンタクト層39と接触している。また、p-Ga As基板31の裏面にはp型電極42が形成されてい る。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の 半導体レーザではp-GaAs基板21とp-ZnSe バッファ層22とのEg (エネルギーギャップ) の差が 40 大きいために起こる電位障壁が、電流を流したときに抵 抗成分となり、熱の発生が起こったり、電流の流れを妨 げ、更に発振の阻害や寿命の低下等の要因となる。本発 明は上記の点に鑑み、電位障壁を低減することによって 熱の発生を抑え、高信頼性の半導体レーザを提供すると とを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成 する手段として、少なくとも、p型GaAs基板上に2

ッド層を有する半導体レーザにおいて、前記p型GaA s基板と前記p型クラッド層との間に、p型ZnCdS e層とp型ZnSe層とを交互に複数積層した超格子層 を有することを特徴とする半導体レーザを提供する。 [0006]

7

【実施例】p-ZnCdSe系半導体はEgがp-Ga Asより大きくp-ZnSeより小さいので、図2にお いてp-GaAs基板31とp-ZnSeバッファ層3 2との間に挿入すればEgをなだらかに変化させ電位障 壁を低減することができる。p-ZnCdSe系半導体 としてはp-ZnCdSeが考えられ、Cd組成を変え ることでEgをp-GaAsの近くからp-ZnSeの Egまで連続的に変化できるので有利である。しかし、 ZnCdSeはGaAsとの格子定数差がありすぎるた め膜(層)に応力がかかるのでp-GaAs基板上に厚 くエピタキシャル成長するのは好ましくない。そこで、 格子定数差の影響が小さい薄い膜厚で作製するためにp - ZnCdSeとp-ZnSeとの超格子層を用いる。 この超格子層の、p-ZnCdSeとp-ZnSeの膜 厚を連続的にかえることで、p-ZnCdSeのCd組 成を疑似的に段階的に変化させることができる。

【0007】以下、添付図面を参照して本発明の実施例 について説明する。図1は、本発明の第一の実施例の半 導体レーザを示す断面図である。まず、p-GaAs基 板11上に、p-ZnCdSe/ZnSe超格子層1 2、p-ZnMgSSeクラッド層13、p-ZnSe 光ガイド層14、u-ZnCdSe活性層15、n-Z nSe光ガイド層16、n-ZnMgSSeクラッド層 17、n-ZnSeコンタクト層18をMBE法により 順次成長させる。

【0008】次に、ポリイミド19をn-ZnSeコン タクト層18の上に塗布し、レジストを用いて電極用の ストライプ部20を開ける。このストライプ部20を介 してn-ZnSeコンタクト層18と接触するようにn 型電極 (AuGeNi/Au) 21を蒸着する。p-G aAs基板11を層厚80μm程度まで研磨し、p-Ga As基板11面にp型電極(AuZn/Au)22を蒸 着する。

【0009】超格子層12は例えば、20オングストロー ムを1単位とするp-ZnCdSeとp-ZnSeとの ペアを複数積層して作製する。例えば、p-GaAs基 板12側からZnCdSeを18オングストローム、Zn Seを 2オングストローム、ZnCdSeを17オングス トローム、ZnSeを 3オングストローム、以下同様に 1オングストロームずつ増減し、ZnCdSeが2オン グストローム、2nSeが18オングストロームのペアま で積層させる。

【0010】なお、本発明の半導体レーザは、上述した 実施例の構造、材質等に限らず、例えばクラッド層の材 nSe系半導体のp型クラッド層、活性層及びn型クラ 50 質はZnSSe等、他のZnSe系半導体でもよい。

(3)

3

[0011]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明の半導体レーザによれば、前記p型GaAs基板とZnSe系半導体のp型クラッド層との間に、p型ZnCdSe層と、p型ZnSe層とを交互に複数積層した超格子層を有するので、p型GaAs基板とp型クラッド層との間の電位障壁が低減し、抵抗成分が減り、熱の発生が抑制できる。従って、信頼性の向上、発振閾値電圧の低下、長寿命化を実現できる。

【図面の簡単な説明】

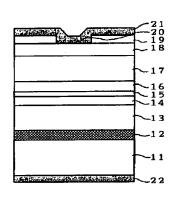
【図1】本発明の一実施例の半導体レーザを示す断面図 である。

【図2】従来の半導体レーザの構造を示す断面図である。

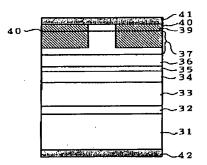
*【符号の説明】

- 11 p-GaAs基板
- 12 p-ZnCdSe/ZnSe超格子層
- 13 p-ZnMgSSeクラッド層
- 14 p-ZnSe光ガイド層
- 15 u-ZnCdSe活性層
- 16 n-ZnSe光ガイド層
- 17 n-ZnMgSSeクラッド層
- 18 n-ZnSeコンタクト層
- 10 19 ポリイミド
 - 20 ストライプ部
 - 21 n型電極
 - 22 p型電極

[図1]



[図2]



THIS PAGE BLANK (USPTO)